エレクトロニクス
実装学会誌

第12巻第3号（通巻第79号）
2009年5月
ISSN 1343-9677

目次

■巻頭言 新たに10年に寄せて／ハリマ化成 松葉倉重 ………………… 169
■特集 プリント配線板のパワーエンジニアリティ
特集に寄せて／日本電気 井上博文 …………………………………… 169
チップ・パッケージ・ボードのパワーエンジニアリティの基礎／京都大学 和田修己 ………………… 170
電源系のターミネート・インピーダンス特性
／日本アイ・ビー・エム 髙橋成正、芝浦工業大学 野瀬正秀、高橋 通 ………………… 175
プリント配線板の電源配線設計とパワーエンジニアリティ／アイ・エム 株式会社 根本 智、中西秀行 ………………… 180
多層プリント配線板における電源・グラウンド解析／沖縄電力㈱ ハワマジシ、芳賀 知 ………………… 186
パワーエンジニアリティのためのコンデンサの適用／村田製作所 山本秀俊 ………………… 190
プリント配線板のパワーエンジニアリティ設計／NEC情報システムズ 矢口貴宏 ………………… 196
配線板間パワーエンジニアリティの3次元シミュレーション解析／日本アイ・ビー・エム 藤尾昇平 ………………… 202

■研究論文
ドリフト拡散デバイスシミュレーションを用いた実装応力に起因するnMOSFETのDC特性変動評価手法
／福岡県工業技術センター 小柄丸正明、京都大学 池田 徹、宮崎則幸、福岡大学 友景 聖 ………………… 208
人体内通信におけるウェアアブル送信機の電磁環境によるインピーダンス整合と電極設計
／東京大学 越地邦明、佐々木 健 ………………… 221

■速報論文
光触媒およびUVを前処理に用いた導電微粒子の作製
／関東学院大学 井上浩治、馬場邦人、本間英夫、関東学院大学表面工学研究所 渡辺充広 ………………… 233

■技術論文
高純度アルミニウムを利用した高耐熱パワーデバイス実装構造における信頼性評価
／横浜国立大学、日立自動車 山崎正憲、横浜国立大学 于 強、藤田雅人、篠原正典、日立自動車 村上善則 ………………… 238

■講座「ちょっとMEMS」第14回
ナノインプリント技術を活用した配線パターンの製作(1)熱インプリントとダマシン法を併用した
バリレン薄膜への銅配線形成／産業技術総合研究所 尾 勝利、髙橋正春 ………………… 248

■研究室訪問 東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻 楽研究室／東京大学 楽 学 ………………… 252
■レポート 第23回エレクトロニクス実装学会講演大会セッションサマリー ………………… 253
お詫びと訂正 ………………………………… 262 本会だより ………………………………… 263
編集後記 ………………………………… 264 会告 ………………………………… ①〜⑦

投稿論文募集
「エレクトロニクス実装学会誌」では、投稿論文を受け付けております。詳しくは
1月号95〜100ページ、またはホームページ（www.e-jisso.jp/publish/index.html）に掲載
の「投稿規程」「査読について」「原稿執筆の手引き」をご覧下さい。また、論文
投稿に関して問い合わせ等ございましたら、Eメール（hensyu@jiep.or.jp）までご連絡
ください。